

電子機器カンパニー
新素材機器カンパニー



2026 年 9 月 17 日～19 日に開催されました **SEMICON India 2026** におきましては、ご多用の中、弊社ブースへお立ち寄りいただき、誠に有り難うございました。
ご来場いただきました皆様に、心より御礼申し上げます。

今回展示致しました、

PLP-700 (パネルレベルパッケージ対応機)

MWS-SiC12F (12 インチ対応マルチワイヤーソー)

GLP-150 (難削材対応研削装置)

につきましては、多くの皆様から高い関心とご好評を賜り、心より感謝申し上げます。

また、会場にて皆様から頂戴致しました貴重なご意見やご質問は、今後の製品開発・技術提案に活かして参ります。

これからも皆様との対話を大切にし、**顧客共創による新たな価値創造と、より付加価値の高いソリューションのご提案**に努めて参ります。

当日ご紹介いたしました製品につきまして、ご意見、ご質問、ご不明な点、またデモンストレーションや評価テスト等の詳細をご希望の際は、どうぞお気軽にお問い合わせください。

今後とも株式会社タカトリをご愛顧賜りますよう、何卒よろしくお願い申し上げます。

